

鉛フリー対応 Lead Free

# 一般用ソルダーペースト Solder Paste for General Use

## LFSOLDER TLF-204-75

優れた洗浄性!  
Excellent cleaning quality!



リフロー後  
After reflow



炭化水素系洗浄剤にて洗浄  
Cleaning with hydrocarbon-based detergent

### 特長

- 炭化水素系洗浄剤、準水系洗浄剤での、洗浄性に優れています。
- 0.4mmピッチ QFP等微小パターンにおいても良好なはんだ付け性を示します。
- はんだ付け性が良好で、各種部品に対しても十分なぬれ性を示します。
- 高温プロファイルにおいても、優れた耐熱性を示します。

### FEATURES

- Residual fluxes can be removed by hydrocarbon-based detergent or quasi water-soluble detergent etc.
- Excellent solderability can be attained at small pattern of 0.4mm pitch QFP.
- Having a good solderability, adequate wettability is shown on various parts.
- Excellent solderability in a high peak temperature.

### 一般特性 General Properties

項目	Item	TLF-204-75	試験方法 Test method
合金組成	Alloy composition (%)	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5	JISZ3282 (1999)
融点	Melting point (°C)	216 / 220	DSC測定 DSC measurement
はんだ粒径	Solder Particle Diameter (μm)	20~38	レーザー解析 Laser analysis
フラックス含有量	Flux content (%)	11.2	JISZ3284 (1994)
塩素含有量	Chlorine content (%)	0.0	JISZ3197 (1999)
粘度	Viscosity (Pa·s)	200	JISZ3284 (1994)
チクソトロピー指数	Thixotropy index	0.58	JISZ3284 (1994)

